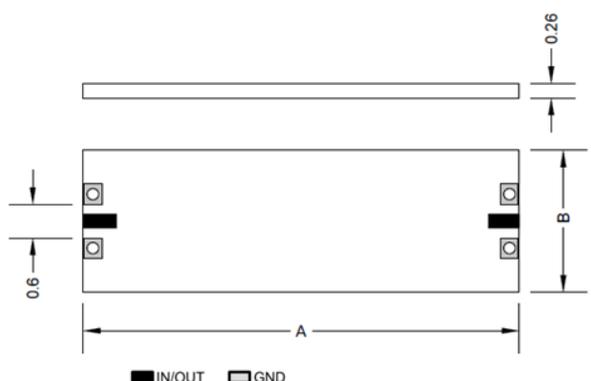


### 技术指标（常温+25°C）

序号	参数	最小	典型	最大	单位
1-1	产品型号	YTFBP12/R2-5SA			
1-2	产品尺寸	4.6mm*3.5mm*0.26mm			
1-3	中心频率 f0		12		GHz
1-4	工作频率	11.9		12.1	GHz
1-5	中心损耗		3.7	4.2	dB
1-6	带内波动		1.5	2.0	dB
1-7	回波损耗	12	15		dB
1-8	带外抑制@11.5GHz	20			dB
	带外抑制@12.5GHz	20			
1-9	承受功率			33	dBm
1-10	工作温度	-55		+85	°C
1-11	存储温度	-55		+125	°C
1-12	输出安装方式	键合			

### 外形尺寸

2-1	外形尺寸	见下图（A、B 外形公差：±0.1mm）
		
2-2	标识尺寸	A: 4.6mm B: 3.5mm （图中尺寸单位为 mm，A、B 外形公差：±0.1mm）
2-3	基板材料	氧化铝 (Er=9.8)
2-4	表面处理	镀金

### 版本状态

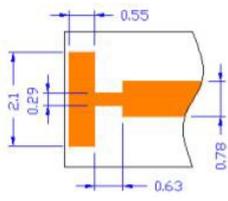
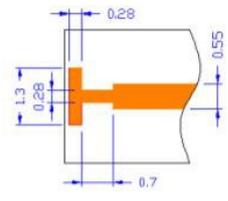
版本号	版本日期	文档状态
V1	20260318	✓

### 建议装配图



### 注意事项

- 1、芯片建议分腔使用，两侧距离侧壁0.2mm左右，表面距离上盖板2mm左右，芯片端口可互换；
- 2、芯片应安装在可伐或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载片上，载体厚度≥0.2mm；
- 3、芯片推荐使用低应力导电胶粘接；
- 4、电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型节尺寸如下：

电路板Rogers5880厚10mil	电路板Rogers4350厚10mil
	
适用频率：DC-38GHz	适用频率：DC-32GHz
注：T型图形顶端基板白边50um；频率10GHz以下无需匹配	

### 仿真曲线：

